

江苏卓胜微电子股份有限公司 关于拟进一步对外投资签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为满足江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展规划及终端应用市场不断扩大带来的市场需求，进一步扩大公司在射频前端领域的竞争力，公司基于在射频前端领域丰富的技术储备、对需求的精准把握和稳定的客户资源，开展芯卓半导体产业化建设项目，实现射频 SAW 滤波器芯片和模组的产业化目标。

2、公司于 2020 年 11 月 28 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于拟对外投资签署合作协议的议案》，同意公司与江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会签署《战略合作协议》，项目投资 8 亿元人民币。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 28 日于巨潮资讯网披露的《江苏卓胜微电子股份有限公司关于拟对外投资签署合作协议的公告》（公告编号：2020-100）。

2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于拟进一步对外投资签署合作协议的议案》，同意对芯卓半导体产业化建设项目追加投资 27 亿元，以进一步扩充 SAW 滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设。

3、芯卓半导体产业化建设项目总投资金额为 35 亿元人民币，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本事项需提交股东大会审议批准。本事项不构成关联交易。

二、协议对方的基本情况

江苏省无锡蠡园经济开发区地处无锡城市中心地带，辖区内共集聚企业 4000 余家，近年来一直聚焦集成电路设计产业链，依托中科芯、清华大学应用研究院、十一科技等龙头央企，汇集技术项目、金融资本、高端人才等产业要素，着力打造无锡滨湖集成电

路设计产业生态圈。园区现有集成电路设计及相关类企业近 150 家，2020 销售收入总额近 50 亿元，同比增长超过 20%。

公司与江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员会不存在关联关系。

三、合作协议的主要内容

项目名称：芯卓半导体产业化建设项目

项目建设内容：射频 SAW 滤波器晶圆制造和射频模组封装测试产能及厂房及配套设施建设扩建

投资规模：项目总投资 35 亿元人民币

资金来源：公司自筹

合同主要内容：（以下内容中甲方为江苏省无锡蠡园经济开发区管理委员，乙方为公司）

甲方承诺：

1、支持乙方享受国家、省、市现行有关投资及产业优惠政策，并按照招商引资相关工作制度，做好项目的推进服务工作。

2、甲方有义务协助乙方办理该项目及配套设施所涉及的土地、规划、环保、建设、立项等事项，甲方指派专人联系乙方，做好项目推进服务工作。

3、甲方保证乙方在符合相关政策条件的情况下，享受各类普惠奖励和优惠政策，不与协议中其他奖励、补助等冲抵。

乙方承诺：

1、乙方的工程建设应按有关法律法规做好项目规划、设计、建设等工作，并报经相关行政许可部门许可。

2、乙方承诺加快项目建设进度，确保及时建成，乙方每季度末须向甲方报送项目投资和建设进度，并保证其真实性。

3、乙方应积极配合甲方进行优惠政策申报的相关工作。

四、对外投资的目的及公司的影响

公司基于在射频前端领域丰富的技术储备、对需求的精准把握和稳定的客户资源，开展芯卓半导体产业化建设项目，针对射频 SAW 滤波器芯片和射频模组产品，导入射频 SAW 滤波器工艺技术与制造设备，形成工艺技术能力和规模化量产能力，抢位射频 SAW 射频滤波器市场份额，实现射频 SAW 滤波器芯片和模组的产业化目标。

通过建设晶圆制造和封装测试生产线，项目建成后，将提升公司在射频 SAW 滤波器领域的整体工艺技术能力和模组量产能力，实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的全产业链布局，提升公司的自主研发创新能力和市场竞争力，最终实现射频 SAW 滤波器芯片和射频模组的国产替代。

本次投资符合公司的战略发展，不会对公司经营的独立性造成不利影响。本项目建成后预计能够实现良好的效益，并将有利于丰富公司的业务领域，为公司现有业务带来协同提升效应，提高公司的抗风险能力和可持续经营能力。

五、风险提示

1、本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的政策风险及项目实施风险。如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化、建设周期进度不及预期等，项目的实施可能存在延期、变更或终止等不确定风险。

2、公司深耕集成电路多年，具有丰富的集成电路研发设计和供应链管理能力和经验，并且通过与供应商合作共建生产专线等方式积累了丰富的管理及运营经验，但自建晶圆制造和封装测试生产线复杂度较高，研发、运营和管理人员将相应增加。如果公司未能根据业务发展状况及时提升人力资源、法律、财务等方面的管理能力，可能会影响项目研发建设进程，导致项目未能按期投入运营的风险。

3、虽然历史上公司不乏与晶圆制造供应商及封装测试供应商合作开发晶圆制造工艺和封装测试工艺的经验，但毕竟工艺技术的开发难度较高，公司缺乏独自成功研制相关技术和工艺的经验，如果公司未来未能根据建设目标及时开发出满足市场需求的技术及工艺，将可能导致本项目的实施存在不确定性，并对公司的生产经营产生一定影响。

4、本项目的实施将会导致公司的费用和成本大幅增加，而产生效益需要一定的时间周期，在本项目产生效益之前，公司的利润实现和股东回报仍主要通过现有业务实现。因此，本项目可能会导致公司的即期回报在短期内有所摊薄。

5、本项目投资资金来源为自筹资金，投资、建设过程中的资金筹措将使公司承担一定的资金财务风险。

六、其他

公司将根据相关事项的进展或变化情况，严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、《战略合作协议之补充协议》。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司

董事会

2021年3月31日